

就活生必見！

半導体産業は人財の宝庫

～世界で活躍するエンジニアたち～

世界を動かすのは、
技術だけじゃない

GLOBAL ENGINEERS

参加費
無料

2026年
9月9日(水) 9:00～11:40

北海道大学 札幌キャンパス&オンライン

応物講演会内 S2会場(総合教育棟 S講義棟 2F)

オンライン申込は[こちら](#)



開催概要

半導体産業は世界のイノベーションを支える中核産業です。
本シンポジウムでは、最前線で活躍するエンジニアが、
各分野の挑戦と未来を語ります。

次世代を担う皆さまのご参加をお待ちしています。

プログラム

09:00～ 開会挨拶 / 応用物理学会副会長(株式会社 東芝) 江崎 瑞仙

09:05～ 基調講演

09:55～ 技術者講演(登壇者 10名)

11:35～ 閉会挨拶 / SEAJ渡部 潔 専務理事

主催 応用物理学会・SEAJ日本半導体製造装置協会

企画 界面ナノ電子化学研究会
インダストリアルチャプター

問い合わせ先 公益社団法人 応用物理学会事務局
Tel : 03-3828-7721 Fax : 03-3828-1810
E-mail : meeting@jsap.or.jp

基調講演

『君たちは、北海道から世界が変わる瞬間を目撃する』
～半導体エコシステムを創る、かつて子どもだった者たちのガチな志～

北海道大学大学院情報科学研究院 教授
秋永 広幸



技術者講演

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 重蔵 卓志
「半導体産業のダイナミズムと面白さ
～やりたいことをやっていたら、たまたま世界で活躍していた～」

株式会社日立ハイテク 田島 和哉
「研究を社会実装へ ～量産を支える装置エンジニアとグローバルな挑戦～」

東京エレクトロン株式会社 小林 累輝
「装置に知性を宿す ～若手が活躍できる開発～」

タワーパートナーズセミコンダクター株式会社 中田 直樹
「世界をつなぐ通信を支える ～グローバルチームで挑む最先端RFSOI技術開発～」

株式会社KOKUSAI ELECTRIC 佐々木 琳太郎
「理想の成膜を目指して ～シミュレーションで挑む装置・プロセス開発～」

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ 河原崎 光
「世界を舞台にした協業マネジメント」

株式会社堀場エステック 中家 佑吾
「最先端の半導体機器開発で感じた世にないものを生み出す面白さ」

株式会社ニコン 鯨岡 優斗
「見えない世界を測る ～ナノメートル精度に挑む計測センサ開発～」

東レエンジニアリング株式会社 重定 瑠士
「産業のコメ?半導体とその実装技術」

キオクシア株式会社 竹田 聖
「データで挑む次世代メモリ開発 - キオクシアのプロセスDX最前線 -」

司会: 横浜国立大学 為近 恵美

就活生必見!!半導体産業は人財の宝庫～世界で活躍するエンジニアたち～ 基調講演者情報

基調講演

君たちは、北海道から世界が変わる瞬間を目撃する
～半導体エコシステムを創る、かつて子どもだった者たちのガチな志～

秋永 広幸 (Hiro Akinaga)

北海道大学 情報科学研究所 教授

半導体フロンティア教育研究機構 半導体研究開発戦略室長

工学博士

<プロフィール>

産業技術総合研究所（産総研）を初めとして、半導体分野で世界最高峰の研究機関の一つであるベルギーのIMECにて客員研究員を務めるなど、一貫して半導体・ナノテクノロジーの研究に携わる。2020年から5年間は、産総研のデバイス技術研究部門の総括研究主幹として、新規デバイス・材料の研究開発を率いてきた。2025年から現職となり、産学官連携を推進するとともに、北大における半導体の教育・研究の中核を担い、北海道から世界への人材輩出・新規技術創出を牽引している。また、国際電気標準会議のコンビーナ（国際標準策定ワーキンググループ統括）として、半導体・ナノテクノロジー分野の国際標準化を主導している。

1992年3月 筑波大学大学院博士課程工学研究科修了 博士(工学)

1992年4月 電子技術総合研究所入所

1997年 ベルギーIMEC 客員研究員

2011年 産業技術総合研究所ナノデバイスセンター長

2015年 科学技術振興機構CRESTさきがけ複合領域「微小エネルギー」
副研究総括

2020年 産業技術総合研究所デバイス技術研究部門総括研究主幹

2024年 鹿児島大学 客員教授

2025年4月 北海道大学情報科学研究所 教授

国際電気標準会議(IEC) TC113 Nanotechnology for electrotechnical products and systems WG7 (Reliability)、WG13 (Wafer-Scale System Integration)
コンビーナ

テ ー マ	半導体産業のダイナミズムと面白さ ～やりたいことをやっていたら、たまたま世界で活躍していた～
ア ブ ス ト ラ ク ト	学生時代は表面科学を専攻し、最初に入社したパナソニックではドライエッチングに従事。その後ソニーへ転職し、学会発表から量産立ち上げまで幅広く活動。さらにイメージセンサ向けの先端パッケージ・3D分野のプロセスインテグレーションへと担当を変え、3Dプロセスインテグレーション研究者としてベルギーの半導体国際研究機関imecに3年間赴任した。imecでは3Dグループに所属し、新規プロセスを提案して研究をリードし、対外イベントや国際会議でもチームを代表し成果を報告してきた。これら自身の経験を踏まえ、イメージセンサを含む半導体産業のダイナミズムと、その中に所属する面白さについてお伝えする。
会 社 名	ソニーセミコンダクタソリューションズ 株式会社
氏 名	重歳 卓志 (Takushi Shigetoshi)
出 身 大 学 名	大阪大学 工学部応用自然科学科精密科学専攻
入 社 年	2013年

テ ー マ	研究を社会実装へ ～量産を支える装置エンジニアとグローバルな挑戦～
ア ブ ス ト ラ ク ト	株式会社日立ハイテクでエッチング装置のプロセスエンジニア業務をしている田島です。開発したプロセスが実際に半導体デバイスの製造工程で実装されるためには量産安定性の検証が必要不可欠です。プロセスエンジニアとして量産安定性の検証と改善に携わった業務経験を共有しながら、この仕事の苦労ややりがいについて話したいと思います。
会 社 名	株式会社 日立ハイテク
氏 名	田島 和哉 (Kazuya Tajima)
出 身 大 学 名	筑波大学大学院 数理物質科学研究群 電子・物理工学専攻
入 社 年	2021年

テ　　ー　　マ	装置に知性を宿す ～若手が活躍できる開発～
アブストラクト	学生時代は電気情報工学を専攻し、古典的な信号処理とディープラーニングの融合に関する研究を行っていました。 2022年の入社後は札幌のTEL AI研究開発拠点で研究開発に従事し、2024年に九州拠点で実機開発、2026年から再び札幌拠点で開発を担当しています。 本講演では自身が開発を主導した機能が装置に搭載された経験をもとに半導体業界に従事する面白さを紹介します。
会　　社　　名	東京エレクトロン 株式会社
氏　　　　　名	小林 累輝 (Ruiki Kobayashi)
出 身 大 学 名	新潟大学大学院 自然科学研究科 電気情報工学専攻
入　　社　　年	2022年

テ　　ー　　マ	世界をつなぐ通信を支える ～グローバルチームで挑む最先端RFSOI技術開発～
アブストラクト	講演タイトルの「RFSOI」はあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、スマートフォンの通信に用いる半導体製品を支える技術の一つです。私はTPSCo入社後、デバイスエンジニアとしてRFSOIの技術開発に携わっています。 本講演では、半導体デバイス開発の仕事内容や魅力に加え、海外の拠点やお客様と協力しながら世界中の技術者と仕事をする日常についてもご紹介します。半導体産業におけるグローバルなキャリアの魅力を感じていただければ幸いです。
会　　社　　名	タワーパートナーズセミコンダクター 株式会社
氏　　　　　名	中田 直樹 (Naoki Nakada)
出 身 大 学 名	東京大学大学院 工学系研究科 原子力国際専攻
入　　社　　年	2021年

テ　　ー　　マ	理想の成膜を目指して ～シミュレーションで挑む装置・プロセス開発～
アブストラクト	大学で熱流体シミュレーションを用いた研究を行い、KOKUSAI ELECTRICに入社後もシミュレーションを用いて半導体製造装置の開発に携わっています。複数のウェーハを一括で処理するバッチ式成膜装置を対象に、すべてのウェーハで均一かつ高品質な膜を得ることを目指して、ガス流れのシミュレーションを行い、装置構成や成膜条件を検討しています。本講演では、私の体験をもとに半導体業界で働くことのやりがいや魅力についてお伝えします。
会　　社　　名	株式会社 KOKUSAI ELECTRIC
氏　　　　　名	佐々木　琳太郎　　　　(Rintaro Sasaki)
出　身　大　学　名	大阪市立大学大学院 工学研究科 機械物理系専攻 （現：大阪公立大学大学院 工学研究科 機械系専攻）
入　　社　　年	2021年

テ　　ー　　マ	世界を舞台にした協業マネジメント
アブストラクト	2022年7月から2026年3月まで、ベルギーにある半導体研究機関 imec に駐在し、先端半導体におけるWETプロセスの研究開発に従事していました。100カ国以上の国から6,500人を超える研究者がいるimecでは、高度な専門知識に加え、多様な価値観や文化の違いを乗り越えながらプロジェクトを推進する力が求められます。困難な場面も多くありましたが、それ以上に大きなやりがいがあり、本講演では海外研究機関でのプロジェクト推進の魅力についてお伝えします。
会　　社　　名	株式会社 SCREENセミコンダクターソリューションズ
氏　　　　　名	河原崎　　光　　　　(Hikaru Kawarazaki)
出　身　大　学　名	京都大学大学院 エネルギー科学研究科
入　　社　　年	2012年

テ　　ー　　マ	最先端の半導体機器開発で感じた世にないものを生み出す面白さ
アブストラクト	私は現在、最先端の半導体成膜装置で使用される材料ガス供給バルブの開発に携わっております。さらに、将来の製品化に向け、大学と共同研究を行っており、最先端の半導体業界の環境に身を置き、様々なことにチャレンジしております。講演では、現在の私の業務の中での取り組みを紹介しながら、最先端の分野でまだ世の中にあるものを生み出すこと面白さについてお話しします。
会　　社　　名	株式会社 堀場エステック
氏　　　　　名	中家　 佑吾　　　　　　　　(Yugo Nakaya)
出 身 大 学 名	奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科
入　　社　　年	2014年

テ　　ー　　マ	見えない世界を測る ～ナノメートル精度に挑む計測センサ開発～
アブストラクト	本発表では私が担当する、半導体ウェハ表面形状を把握するための計測センサの開発業務について紹介します。半導体製造では数nmレベルの凹凸が露光精度に影響を及ぼすため、表面形状を高精度に把握することが必要になります。目に見えない大きさをどのように測定しているのか、見えないゆえに生じる課題や失敗、それらへの向き合い方についてお伝えいたします。また、一見業務とは異なる専攻をどう生かしてきたのかについても紹介させていただきます。
会　　社　　名	株式会社 ニコン
氏　　　　　名	鯨岡　 優斗　　　　　　　　(Yuto Kujiraoka)
出 身 大 学 名	東京工業大学 生命理工学部生命理工学系分子生物学
入　　社　　年	2024年

テ ー マ	産業のコメ？半導体とその実装技術
ア ブ ス ト ラ ク ト	東レエンジニアリング株式会社の重定です。学生時代は半導体の微細加工プロセスについて研究をしていました。現在入社3年目で、ボンダーという半導体製造装置に携わっています。このボンダー装置については、普段馴染みのない言葉かと思います。本発表では、そもそも半導体とはどういったものであるかということを説明し、そして私が携わっているボンダー装置によって行われる半導体実装の技術についてお話しします。
会 社 名	東レエンジニアリング 株式会社
氏 名	重定 瑠士 (Ruiji Shigesada)
出 身 大 学 名	滋賀県立大学大学院 工学研究科・電子システム工学専攻
入 社 年	2024年

テ ー マ	データで挑む次世代メモリ開発 - キオクシアのプロセスDX最前線 -
ア ブ ス ト ラ ク ト	私は2024年に入社し、AI/DXを活用した半導体プロセス開発のスマート化技術の研究開発に従事しています。学生時代には、AIを用いたX線応力測定装置の高速化という半導体とは異なる分野の研究に取り組んでいました。そのため、入社後の研究は「異分野への挑戦」でもありますが、大きなやりがいを感じながら日々取り組んでおります。今回は、半導体プロセス開発におけるAI活用事例のご紹介を通じて、「プロセスDX」の魅力をお伝えできればと思います。
会 社 名	キオクシア 株式会社
氏 名	竹田 聖 (Sho Takeda)
出 身 大 学 名	東京都市大学 総合理工学研究科 機械専攻 機械システム工学領域
入 社 年	2024年

